

## CLH-HM01 厚膜包封浆料

### 产品介绍

CLH-HM01是一款低温无镉玻璃包封浆料，旨在形成厚膜电路的绝缘和保护层，特别是激光调阻的厚膜电阻器。它通过丝网印刷应用于陶瓷基板，并在传送带炉中在空气(氧化)气氛中烧制。

### 典型性能

性能	指标
烧结厚度 (um)	10-12
粘度Pa.s	80-130
印刷面积 (cm <sup>2</sup> /g)	110-130

### 产品特点

无镉产品

包封后的电阻值变化为 1-5%

表面光滑

### 推荐工艺

**基板:** CLH-HM01性能是基于96%氧化铝基板的测试。其他成分的基板和不同制造商的基板可能会导致性能属性的变化。

**印刷:** 推荐使用 325目不锈钢丝网，印刷速度可达 30厘米/秒，烧结厚度应达到 11um。印刷应该在清洁通风的环境中进行，在 20-23℃环境中印刷浆料具有最佳的印刷性能。

**干燥:** 浆料印刷后，在室温下流平 5-10 分钟，然后在通风的烘箱或传送带式干燥炉中150℃干燥 10-15 分钟。

**烧结:** 通过链式炉烧结，500~510℃的峰值温度，在峰值温度(小于1分钟)下不停留，总烧结周期为 20~25 分钟。为了避免有机物滞留在烧制的膜层中，建议在 300℃ 至400℃ 的加热过程中允许足够的时间(5-10 分钟)。包封过程中电阻值会发生可预测的变化，通常为 1至5%，这取决于电阻的组成和烧结温度。

激光修调玻璃釉包封的电阻，激光修调通常与未包封的电阻相似。只要包封玻璃釉厚度为 10-12 微米，只需适当地增加激光束功率或改变顺序操作参数即可。

**存储和有效期:** 浆料应在密闭的容器中清洁、温度稳定的环境中保存，温度小于 25℃。在没有打开容器的情况下，保质期为发货日期6 个月。长时间存放可能会发生固体物沉降，使用前进行充分搅拌。

**安全与处理:** 本产品含有有机溶剂和材料，在使用CLH-HM01时应采取以下预防措施：

在有足够通风的情况下使用；

避免长时间接触皮肤避免长时间吸入蒸汽；

如接触皮肤，应立即用肥皂和水清洗患处；

吞食有危险；